

中国低功耗芯片行业现状深度研究与投资前景分析 报告（2024-2031年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国低功耗芯片行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202410/730729.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

低功耗芯片 是指设计上特别注重降低能耗的集成电路，这类芯片通常采用先进的工艺技术，如 CMOS（互补金属氧化物半导体）工艺，以减少静态和动态功耗，从而延长设备的电池寿命。

我国低功耗芯片行业相关政策

为提升芯片供给能力，我国发布了一系列行业政策，如2024年工业和信息化部发布的《关于开展2024年度5G轻量化（RedCap）贯通行动的通知》提出鼓励芯片企业加强技术攻关，完成不少于3款芯片研发并推进产业化。组织开展5G RedCap芯片的协议一致性和网络兼容性测试，不断提升芯片性能。加速模组产业化进程，提升模组产品能力以及与终端的适配能力，结合市场需求，进一步推动5G RedCap模组价格下降。

我国低功耗芯片行业相关政策	发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
	2023年3月	国家能源局	关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见	加快推动能源领域工控系统、芯片、操作系统、通用基础软硬件等自主可控和安全可靠应用。
	2023年4月	工业和信息化部等八部门	关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见	瞄准网络处理器、交换芯片、高速串行接口、可编程逻辑器件、专用软件等产业链关键环节，充分发挥产业链下游用户企业的需求牵引作用，加强全链条协同联动，补齐产业链短板，不断提升产业链安全水平。

电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案

	2023年8月	工业和信息化部、财政部		
				着力提升芯片供给能力，积极协调芯片企业与应用企业的对接交流。
	2023年9月	国家发展改革委、国家能源局	关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见	提高电力工控芯片、基础软件、关键材料和元器件的自主可控水平，强化电力产业链竞争力和抗风险能力。
	2024年2月	工业和信息化部等七部门	关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见	在新一代信息技术领域，引导数据中心扩大绿色能源利用比例，推动低功耗芯片等技术产品应用，探索构建市场导向的绿色低碳算力应用体系。

市场监管总局、中央网信办等部门

				贯彻实施 国家标准化发展纲要 行动计划（2024—2025年）健全产业基础标准体系。制修订精密减速器、高端轴承、车规级汽车芯片等核心基础零部件（元器件）共性技术标准，推动解决产品高性能、高可靠性、长寿命等关键问题。
	2024年4月	工业和信息化部		
				关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知

鼓励芯片企业加强技术攻关，完成不少于3款芯片研发并推进产业化。组织开展5G RedCap芯片的协议一致性和网络兼容性测试，不断提升芯片性能。加速模组产业化进程，提升模组产品能力以及与终端的适配能力，结合市场需求，进一步推动5G RedCap模组价格下降。

	2024年8月	工业和信息化部		关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知
				鼓励芯片、模组企业加快技术创新和产业化。

资料来源：观研天下整理

部分省市低功耗芯片行业相关政策

我国各省市也积极响应国家政策规划,对各省市低功耗芯片行业的发展做出了具体规划,支持当地低功耗芯片行业稳定发展,比如广东省发布的《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》提出加快建设储能控制芯片重大制造项目,大力发展新型储能用高性能、低损耗、高可靠的绝缘栅双极型晶体管功率器件及模块,推动碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体功率器件产业化推广及应用。

部分省市低功耗芯片行业相关政策	发布时间	省市	政策名称	主要内容
	2023年4月	内蒙古自治区	全区一体化政务大数据体系建设工作方案	按需打造图像显示处理器（GPU）、专用集成电路芯片（ASIC）等异构计算能力，构建存算分离、图计算、隐私计算等新型数据分析管理能力。

	2023年4月	河南省	河南省加强数字政府建设实施方案（2023—2025年）	按需提升图像显示处理器、专用集成电路芯片等异构计算能力，强化存算分离、图计算、隐私计算等新型数据分析管理能力。
--	---------	-----	-----------------------------	---

	2023年4月	河南省	河南省加强数字政府建设实施方案（2023—2025年）	鼓励探索提供软件即服务、数据即服务等高阶服务，强化适配容器、服务网格、微服务、不可变基础设施、声明式应用程序编程接口等云原生代表技术应用，按需提升图像显示处理器、专用集成电路芯片等异构计算能力，强化存算分离、图计算、隐私计算等新型数据分析管理能力。
--	---------	-----	-----------------------------	--

	2023年5月	北京市	北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）	推动国产人工智能芯片实现突破。面向人工智能云端分布式训练需求，开展通用高算力训练芯片研发；面向边缘端应用场景的低功耗需求，研制多模态智能传感芯片、自主智能决策执行芯片、高效边缘端异构智能芯片；面向创新型芯片架构，探索可重构、存算一体、类脑计算、Chiplet等创新架构路线。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片，加快提升人工智能算力供给的国产化率。
--	---------	-----	--	---

	2023年5月	江西省	江西省新能源产业数字化转型行动计划（2023-2025年）	鼓励企业加强对攻击防护、漏洞挖掘、入侵发现、态势感知、安全审计、可信芯片等安全技术产品和解决方案的应用，建立自主可控信息技术体系。
--	---------	-----	-------------------------------	---

	2023年6月	江西省	江西省制造业数字化转型实施方案	强化人工智能技术应用，发展智能硬件产品，加快智能传感终端、高端芯片、通用处理器等领域研发突破和迭代应用。
--	---------	-----	-----------------	--

	2023年7月	山西省	关于促进企业技术改造的实施意见	半导体产业加强材料、装备、芯片、封装等领域布局，发展集成电路、光电器件、分立器件、传感器等产品，推动碳化硅衬底材料规模化生产。
--	---------	-----	-----------------	---

	2023年8月	宁夏回族自治区	促进人工智能创新发展政策措施	积极引进国内服务器制造龙头企业，发挥其在供应链的优势，整合数字产业生态资源，重点推动服务器制造、基础芯片的产学研及配套产业建设，吸引更多算力设施企业加入，培育算力设施规模化、集群化，带动建立服务器及其核心部件的制造链，打造本地化产业生态。
--	---------	---------	----------------	---

	2023年9月	河北省	关于促进电子信息产业高质量发展的意见	实施先进制造业集群发展专项
--	---------	-----	--------------------	---------------

行动，围绕集成电路等战略性领域，建立京津冀协同培育机制，强化区域联动和政策协同，加强产业链供应链协作，培育集基础材料、芯片设计、工艺制造、封装测试于一体的集成电路先进制造业集群。

2024年2月 安徽省 安徽省有效投资专项行动方案（2024）实施集成电路领域关键技术攻关，支持动态存储芯片等重大项

2023年3月 广东省 广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见 加快建设储能控制芯片重大制造项目，大力发展新型储能用高性能、低损耗、高可靠的绝缘栅双极型晶体管功率器件及模块，推动碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体功率器件产业化推广及应用。

2024年5月 广东省 广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施 建立人工智能芯片生态体系。建设适配芯片的开发生态，面向家电家居、安防监控、医疗设备等，加大高性能、低功耗的端侧芯片开发生产。

2023年10月 上海市 上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）针对地面与卫星融合通信的新场景，开展场景智能识别、基于业务无感知的高可靠无缝切换等关键技术研究，研制满足6G空天地一体化系统性能需求、低成本、低功耗的终端芯片及模组。

2024年7月 上海市 上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案（2024-2027年）鼓励集成电路设计企业探索IP硬件化、高端系统级芯片IP拼图式研发新模式，提高集成电路设计能力和芯片三维集成制造能力。

2024年7月 天津市 天津市算力产业发展实施方案（2024—2026年）提升关键技术创新能力。聚焦突破“卡脖子”技术，支持企业加快人工智能（AI）芯片布局，推进国产化中央处理器（CPU）、深度计算处理器（DCU）、数据处理器（DPU）、神经网络处理器（NPU）等算力核心芯片技术路线整合和产品迭代。夯实自主可控软件基础，加快操作系统、数据库、应用等软件开发，推进应用软件与国产主流芯片、操作系统和人工智能框架的适配。

资料来源：观研天下整理（XD）

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。更多图表和内容详见报告正文。

观研报告网发布的《中国低功耗芯片行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。

本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风

险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。

本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

【目录大纲】

第一章 2019-2023年中国低功耗芯片行业发展概述

第一节低功耗芯片行业发展情况概述

一、低功耗芯片行业相关定义

二、低功耗芯片特点分析

三、低功耗芯片行业基本情况介绍

四、低功耗芯片行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、低功耗芯片行业需求主体分析

第二节中国低功耗芯片行业生命周期分析

一、低功耗芯片行业生命周期理论概述

二、低功耗芯片行业所属的生命周期分析

第三节低功耗芯片行业经济指标分析

一、低功耗芯片行业的赢利性分析

二、低功耗芯片行业的经济周期分析

三、低功耗芯片行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球低功耗芯片行业市场发展现状分析

第一节全球低功耗芯片行业发展历程回顾

第二节全球低功耗芯片行业市场规模与区域分布情况

第三节亚洲低功耗芯片行业地区市场分析

一、亚洲低功耗芯片行业市场现状分析

二、亚洲低功耗芯片行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲低功耗芯片行业市场前景分析

第四节北美低功耗芯片行业地区市场分析

一、北美低功耗芯片行业市场现状分析

二、北美低功耗芯片行业市场规模与市场需求分析

三、北美低功耗芯片行业市场前景分析

第五节 欧洲低功耗芯片行业地区市场分析

一、欧洲低功耗芯片行业市场现状分析

二、欧洲低功耗芯片行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲低功耗芯片行业市场前景分析

第六节 2024-2031年世界低功耗芯片行业分布走势预测

第七节 2024-2031年全球低功耗芯片行业市场规模预测

第三章 中国低功耗芯片行业产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

第二节 我国宏观经济环境对低功耗芯片行业的影响分析

第三节 中国低功耗芯片行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节 政策环境对低功耗芯片行业的影响分析

第五节 中国低功耗芯片行业产业社会环境分析

第四章 中国低功耗芯片行业运行情况

第一节 中国低功耗芯片行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国低功耗芯片行业市场规模分析

一、影响中国低功耗芯片行业市场规模的因素

二、中国低功耗芯片行业市场规模

三、中国低功耗芯片行业市场规模解析

第三节 中国低功耗芯片行业供应情况分析

一、中国低功耗芯片行业供应规模

二、中国低功耗芯片行业供应特点

第四节 中国低功耗芯片行业需求情况分析

一、中国低功耗芯片行业需求规模

二、中国低功耗芯片行业需求特点

第五节 中国低功耗芯片行业供需平衡分析

第五章 中国低功耗芯片行业产业链和细分市场分析

第一节 中国低功耗芯片行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、低功耗芯片行业产业链图解

第二节 中国低功耗芯片行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对低功耗芯片行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对低功耗芯片行业的影响分析

第三节 我国低功耗芯片行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国低功耗芯片行业市场竞争分析

第一节 中国低功耗芯片行业竞争现状分析

一、中国低功耗芯片行业竞争格局分析

二、中国低功耗芯片行业主要品牌分析

第二节 中国低功耗芯片行业集中度分析

一、中国低功耗芯片行业市场集中度影响因素分析

二、中国低功耗芯片行业市场集中度分析

第三节 中国低功耗芯片行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国低功耗芯片行业模型分析

第一节 中国低功耗芯片行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节中国低功耗芯片行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国低功耗芯片行业SWOT分析结论

第三节中国低功耗芯片行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国低功耗芯片行业需求特点与动态分析

第一节中国低功耗芯片行业市场动态情况

第二节中国低功耗芯片行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节低功耗芯片行业成本结构分析

第四节低功耗芯片行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节中国低功耗芯片行业价格现状分析

第六节中国低功耗芯片行业平均价格走势预测

一、中国低功耗芯片行业平均价格趋势分析

二、中国低功耗芯片行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国低功耗芯片行业所属行业运行数据监测

第一节中国低功耗芯片行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节中国低功耗芯片行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节中国低功耗芯片行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国低功耗芯片行业区域市场现状分析

第一节中国低功耗芯片行业区域市场规模分析

一、影响低功耗芯片行业区域市场分布的因素

二、中国低功耗芯片行业区域市场分布

第二节中国华东地区低功耗芯片行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区低功耗芯片行业市场分析

(1) 华东地区低功耗芯片行业市场规模

(2) 华东地区低功耗芯片行业市场现状

(3) 华东地区低功耗芯片行业市场规模预测

第三节华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区低功耗芯片行业市场分析

(1) 华中地区低功耗芯片行业市场规模

(2) 华中地区低功耗芯片行业市场现状

(3) 华中地区低功耗芯片行业市场规模预测

第四节华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区低功耗芯片行业市场分析

- (1) 华南地区低功耗芯片行业市场规模
- (2) 华南地区低功耗芯片行业市场现状
- (3) 华南地区低功耗芯片行业市场规模预测

第五节华北地区低功耗芯片行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区低功耗芯片行业市场分析

- (1) 华北地区低功耗芯片行业市场规模
- (2) 华北地区低功耗芯片行业市场现状
- (3) 华北地区低功耗芯片行业市场规模预测

第六节东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区低功耗芯片行业市场分析

- (1) 东北地区低功耗芯片行业市场规模
- (2) 东北地区低功耗芯片行业市场现状
- (3) 东北地区低功耗芯片行业市场规模预测

第七节西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区低功耗芯片行业市场分析

- (1) 西南地区低功耗芯片行业市场规模
- (2) 西南地区低功耗芯片行业市场现状
- (3) 西南地区低功耗芯片行业市场规模预测

第八节西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区低功耗芯片行业市场分析

- (1) 西北地区低功耗芯片行业市场规模
- (2) 西北地区低功耗芯片行业市场现状
- (3) 西北地区低功耗芯片行业市场规模预测

第十一章 低功耗芯片行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第六节企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第七节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第八节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第九节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第十节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

第十二章 2024-2031年中国低功耗芯片行业发展前景分析与预测

第一节中国低功耗芯片行业未来发展前景分析

- 一、低功耗芯片行业国内投资环境分析
- 二、中国低功耗芯片行业市场机会分析
- 三、中国低功耗芯片行业投资增速预测

第二节中国低功耗芯片行业未来发展趋势预测

第三节中国低功耗芯片行业规模发展预测

- 一、中国低功耗芯片行业市场规模预测
- 二、中国低功耗芯片行业市场规模增速预测
- 三、中国低功耗芯片行业产值规模预测
- 四、中国低功耗芯片行业产值增速预测
- 五、中国低功耗芯片行业供需情况预测

第四节中国低功耗芯片行业盈利走势预测

第十三章 2024-2031年中国低功耗芯片行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国低功耗芯片行业进入壁垒分析

- 一、低功耗芯片行业资金壁垒分析
- 二、低功耗芯片行业技术壁垒分析
- 三、低功耗芯片行业人才壁垒分析
- 四、低功耗芯片行业品牌壁垒分析
- 五、低功耗芯片行业其他壁垒分析

第二节低功耗芯片行业风险分析

- 一、低功耗芯片行业宏观环境风险
- 二、低功耗芯片行业技术风险
- 三、低功耗芯片行业竞争风险
- 四、低功耗芯片行业其他风险

第三节中国低功耗芯片行业存在的问题

第四节中国低功耗芯片行业解决问题的策略分析

第十四章 2024-2031年中国低功耗芯片行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国低功耗芯片行业研究综述

- 一、行业投资价值
- 二、行业风险评估

第二节中国低功耗芯片行业进入策略分析

- 一、行业目标客户群体
- 二、细分市场选择
- 三、区域市场的选择

第三节低功耗芯片行业营销策略分析

- 一、低功耗芯片行业产品策略
- 二、低功耗芯片行业定价策略
- 三、低功耗芯片行业渠道策略
- 四、低功耗芯片行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202410/730729.html>